

TECHNOVIT5000 取扱説明

導電性埋込樹脂(電解研磨,SEM,マイクロプローブ等各種電子顕微鏡に使用できます。)
テクノビット5000は、下記の電顕用の埋め込み樹脂用として最適です。

走査型電子顕微鏡
電解研磨(透過型電子顕微鏡)
マイクロプローブ

作業が簡単かつ短時間で硬化。また、導電性も高く必ず良い結果が得られます。
常温硬化メチルメタクリレート樹脂、2成分系:粉末+液、色:茶

処理時間: 1~2分、鑄注可能、加熱なしに約6分(22°C)で硬化します。機械加工も可能です。

導電組成: 銅

硬化時の最高温度: 125°C(15g使用時)

耐熱性: 100°C

可溶性: クロロ炭化水素(トリクロロエタン)に膨潤する。

混合比: 重量比 粉末:液 = 1:1

調合手順: ①液を計算し混合容器へ入れます。②粉末を秤量し、液に少しずつ投入しながら、静かに攪拌します。③包埋容器に試料を入れ、2の混合液を静かに注入してください。約6分(22°C)程度で重合硬化が終了します。重合硬化中は温度が125°C程度まで上昇しますので、温度が下がるまで、暫く放置した後、包埋容器から取り出してください。